

中国半导体行业协会半导体分立器件分会

中半器协[2019] 002 号

第十二届中国微纳电子技术交流与学术研讨会 会议通知

微纳电子技术涉及电子、机械、物理、化学、生物、医学、材料、制造、测试等多学科领域，是一门多学科交叉渗透和综合的高新技术，是未来技术更新换代和新兴产业发展的重要基础。为进一步推动我国微纳电子技术的快速发展，为大家提供一个了解国内外微纳电子技术最新发展动态的交流平台，第十二届“中国微纳电子技术交流与学术研讨会”定于2019年10月25—27日在苏州市举行。大会特邀海内外微纳电子技术领域的知名院士、专家、教授等作大会主题报告，欢迎海内外广大科研人员、高校师生以及产业界技术人员积极参与。

一 会议报告

特邀报告

| | |
|----------------------|---------|
| 北京大学纳米化学中心主任 | 刘忠范 院 士 |
| 清华大学信息科学技术学院副院长 | 任天令 教 授 |
| 中国电子科技集团公司原副总经理 | 赵正平 研究员 |
| 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 李昕欣 研究员 |
| 东南大学 MEMS 教育部重点实验室主任 | 黄庆安 教 授 |
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 张卫平 教 授 |
| 厦门大学萨本栋微米纳米科技技术研究院 | 吕 苗 教 授 |
| 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | 任凯亮 研究员 |
| 河北美泰电子科技有限公司 | 吝海锋 研究员 |

邀请报告

| | |
|-----------------|---------|
| 中国科学院物理研究所 | 韩秀峰 研究员 |
| 深迪半导体（上海）有限公司 | 邹 波 总经理 |
| 昆山双桥传感器测控技术有限公司 | 王 冰 总经理 |

二 会议组织机构

主办单位：中国半导体行业协会分立器件分会

承办单位：元器件封装技术创新中心

专用集成电路重点实验室

河北普兴电子科技股份有限公司

苏州纳米科技发展有限公司

苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司

苏州市集成电路行业协会

中国半导体行业协会 MEMS 分会

中国电子科技集团公司第十三研究所

协办单位：合肥锐拓科技信息服务有限公司

南京佳优会议服务有限公司

《微纳电子技术》编辑部

《半导体技术》编辑部

三 会议内容

1. 纳米电子学、纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米加工学和纳米计量学的基础研究；
2. 纳米电子材料、光学和光电子材料、磁性材料、仿生材料、纳米生物材料、医学材料和智能材料等的结构设计与制备技术；
3. 微米/纳米电子元器件、光学器件与系统的设计、制造和集成技术；
4. 微米/纳米加工技术(包括纳米颗粒表面催化反应、纳米颗粒自组装、纳米结构及生长、微/纳米蚀刻等)、纳米组装技术、分子自组装技术；
5. MEMS/NEMS 系统、微纳米传感器与执行器、微型构件、微机械光学器件、纳米机器人等的设计、制造及集成技术；
6. 微流体及纳流体、微流控器件和系统的设计、制作与应用；
7. 微能源与传热技术；
8. 纳米检测技术 (纳米结构的检测手段、表征方法和仪器设备)；
9. 微米/纳米技术在计算机和信息系统、生物医学工程、航空航天、环境和能源、国家安全等领域的应用；
10. 微米/纳米材料与器件低成本批量制造技术的开发、产业化推进和市场前景展望；
11. 微细加工技术生产设备的研制及应用；
12. 微米/纳米科技创新、技术转换等；
13. 其他相关技术。

四 摘要与论文

为便于会议内容的审定和作为会议资料之一的《论文摘要文集》的印制，如您有报告或论文参会，请将“论文题目、作者单位、500 字左右中文**摘要**、作者简介、详细联系方式（包括手机号码和 E-mail 地址）”于 9 月 24 日前发至编辑部（E-mail:wndz@vip.sina.com）。

本届会议在全国范围内征文，优秀论文将在《微纳电子技术》(中文核心期刊)正刊上免费发表。

五 会议时间、地点

1. 会议时间：2019 年 10 月 25 日报到，26 日至 27 日开会。

2.会议地点：在水一方大酒店，苏州市相城区尊园路1号。

六 会议代表注册费

每位代表会议注册费 2000 元、编委会成员参会注册费 1600 元、学生凭学生证会议注册费 1600 元，报到时统一收取，住宿费自理。

七 企业形象和产品展示

会议邀请国内外厂商参与企业形象和产品展示，承办者将以优惠条件提供场所和服务。

八 会议联系方式

半导体分立器件分会秘书处 《微纳电子技术》编辑部

联系人：李永 电话：0311-87091519 13933075237 18630198776

传真：0311-87091477 邮箱：polaris13@vip.163.com



中国半导体行业协会半导体分立器件分会
2019年5月09日